

御中

製品仕様書
PRODUCT SPECIFICATION

製品名
Product Name

SMD コネクタ
SMD CONNECTOR

受領印欄
Acknowledged sign

△	'05.11.28	誤記訂正	清水	(換)	承認 Appr.	確認 Conf.	作成 Making
△	'05. 6.13	アイテム追加 (32 ~ 40P)	清水	堀内			
△	'04.12. 8	角ピン半田メッキ削除	清水	堀内	椎根	堀内	草野
△	'03. 2.20	角ピンSnメッキ仕様追加	草野	堀内			
Prop.	'00. 5.15		-	-			
No,	Date	変更内容 Revision Record	Charge	Appr.			

仕 様 書 SPECIFICATIONS

SA-1381S-E4-3/12

4 . 形状・寸法及び材料 (SHAPE, SIZE AND MATERIALS)

添付図面による。From the attached drawings.

図 面 番 号 Drawing No.	製 品 名 Product Name	記 号 Mark
J C - 0 8 0 7 - 0 1 E	SMD コネクタ (ストレート型) SMD Connector S-Type	0
J C - 0 8 0 7 - 0 7 E	SMD コネクタ (ストレート型) SMD Connector S-Type	0
△ J C - 0 8 0 7 - 7 5 E	SMD コネクタ (ストレート型) SMD Connector S-Type	0
J C - 0 8 0 7 - 0 5 E	SMD コネクタ (アンクル型) SMD Connector L-Type	0
J C - 0 8 0 7 - 1 2 E	SMD コネクタ (アンクル型) SMD Connector L-Type	0
△ J C - 0 8 0 7 - 7 8 E	SMD コネクタ (アンクル型) SMD Connector L-Type	0
J C - 0 8 0 7 - 0 2 E	コネクタ Contact	0
J C - 0 8 0 7 - 0 3 E	SMD ハウジング SMD Housing	0
J C - 0 8 0 7 - 0 9 E	SMD ハウジング SMD Housing	0
△ J C - 0 8 0 7 - 7 6 E	SMD ハウジング SMD Housing	0
△△ J C - 0 8 0 7 - 0 4 E	SMD ウェハ (ストレート型) SMD Wafer S-Type	△
△△ J C - 0 8 0 7 - 1 0 E	SMD ウェハ (ストレート型) SMD Wafer S-Type	△
△ J C - 0 8 0 7 - 7 7 E	SMD ウェハ (ストレート型) SMD Wafer S-Type	0
△△ J C - 0 8 0 7 - 0 6 E	SMD ウェハ (アンクル型) SMD Wafer L-Type	△
△△ J C - 0 8 0 7 - 1 1 E	SMD ウェハ (アンクル型) SMD Wafer L-Type	△
△ J C - 0 8 0 7 - 7 9 E	SMD ウェハ (アンクル型) SMD Wafer L-Type	0

仕 様 書 SPECIFICATIONS

SA-1381S-E4-2/12

1. 適用範囲 (APPLICATION SCOPE)

この製品仕様書は「SMDコネクタ」の一般仕様及び性能について規定する。
This specification shall be applied to 「SMD Connector」.

2. 製品名・製品番号 (PRODUCT NAME & CATALOG NO.)

製品名 Product Name	製品番号 J.A.M.Co.,Ltd Catalog No.	材料及び表面処理 Materials and Surface Finish
コンタクト Contact	7 2 5 4 1 6 - 2 M A C	リン青銅 錫鍍金材 Phosphor Bronze Pre-tin Plated
ハウジング Housing	SMD 2 5 - H G	ナイロン 6 6 UL94V-0 Nylon66 UL94V-0
ウエハー Wafer ストレート型 S-Type アングル型 L-Type	SMD 2 5 - W S SMD 2 5 - W L	ナイロン 6 6 UL94V-0(GF入) Nylon 66 UL94V-0(GF)

3. 定 格 (RATINGS)

項目 Items	規格値 Requirement	
定格電圧 Rated voltage	2 5 0 V A C . D C	
定格電流 Rated Current	3 A 適用最大電線による By Maximum Wire	
使用温度範囲 Temperature Range	- 4 0 ~ + 8 5 (通電による温度上昇分を含む) (Including rise by electrifying)	
適用電線範囲 Wire Size	AWG# 2 8 ~ # 2 2 最大被覆外径 Maximum Diameter of Insulation 1.7mm	
適用基板 Applicable P.C.B.	穴径 Hole Dia.	1.0 ± 0.05mm
	ピッチ Hole Pitch	2.54 ± 0.05mm
	厚さ Thickness	1.2 ~ 1.6 mm
保存温度範囲 Keeping Temperature	- 3 0 ~ + 6 0 (90%RH 以下) (90%RH or less)	

5 . 性能 (CHARACTERISTICS)

性能は、下表に示す試験条件及び方法で試験を実施したとき、各項目に規定する規格値を満足すること。尚、試験は特に指定のない限り、温度 15 ~ 35 、相対湿度 25 ~ 75 % にて実施する。

The performance shall be satisfied with the values in following table under the limited experiment conditions and methods. Unless other specified, measurements shall be made by referring to temperature 15~35 、relative humidity 25~75%) .

5-1 外観 (Appearance)

No.	項 目 Items	規 格 値 Requirements	試験条件及び方法 Conditions
5-1-1	外 観 Appearance	使用上有害となる様な割れ・変形等が無いこと Without any harmful problems like crack and deformation for application.	目 視 Eye check

5-2 機械的性能 (Mechanical characteristics)

No.	項 目 Items	規 格 値 Requirement	試験条件及び方法 Conditions and methods
5-2-1	挿 入 力 Insertion Force	10 P	74.5N 以下 or less
		12 P	88.2N 以下 or less
		14 P	101.9N 以下 or less
		16 P	115.6N 以下 or less
		18 P	129.4N 以下 or less
		20 P	143.1N 以下 or less
		22 P	156.8N 以下 or less
		24 P	170.5N 以下 or less
		26 P	184.2N 以下 or less
		28 P	198.0N 以下 or less
		30 P	211.7N 以下 or less
		㊦ 32 P	225.3N 以下 or less
		㊦ 34 P	239.0N 以下 or less
		㊦ 36 P	252.7N 以下 or less
		㊦ 38 P	266.4N 以下 or less
㊦ 40 P	280.0N 以下 or less		
			ターミナルをハウジングに装着し、 ウエハーへの挿入力を万能試験機を用いて測定する。 試験速度 2.5mm/min Measurements of insertion forces shall be made. Pull out speed 25 mm/min

仕 様 書 SPECIFICATIONS

SA-1381S-E4-5/12

No.	項 目 Items	規 格 値 Requirement		試 験 条 件 及 び 方 法 Conditions and methods
5-2-2	引 抜 力 Withdraw Force	10P	11.8N 以上 or more	ターミナルをハウジングに装着し、 ハウジングロックを除去してウエハ ーからの引抜力を万能試験機を用い て測定する。 試験速度 25mm/min Measurements of withdraw forces shall be made after removing the housing lock. Pull out speed 25 mm/min
		12P	13.7N 以上 or more	
		14P	16.5N 以上 or more	
		16P	18.8N 以上 or more	
		18P	21.2N 以上 or more	
		20P	23.5N 以上 or more	
		22P	26.5N 以上 or more	
		24P	28.4N 以上 or more	
		26P	31.4N 以上 or more	
		28P	33.3N 以上 or more	
		30P	36.3N 以上 or more	
		△ 32P	37.8N 以上 or more	
		△ 34P	40.1N 以上 or more	
		△ 36P	42.5N 以上 or more	
△ 38P	44.8N 以上 or more			
△ 40P	47.2N 以上 or more			
5-2-3	コンタクト 挿入力 Contact Inserting Force	6.9 N 以下 or less		ハウジングへのコンタクト挿入力を 万能試験機を用いて測定する。 試験速度 25mm/min Putting contact into housing after which measurements shall be made. Pull out speed 25 mm/min
5-2-4	コンタクト 保持力 Contact Holding Force	19.6 N 以上 or more		ハウジングとコンタクトの保持力を 万能試験機を用いて測定する。 試験速度 25mm/min Measurement shall be made before the contact is drawn out from housing. Pull out speed 25 mm/min

仕 様 書 SPECIFICATIONS

SA-1381S-E4-6/12

No.	項 目 Items	規 格 値 Requirement		試 験 条 件 及 び 方 法 Conditions and methods	
5-2-5	ハウジング ロック強度 Housing Lock Force	29.4 N 以上 or more		ハウジングとウエハーのロック強度を万能試験機を用いて測定する。 試験速度 25mm/min The force shall be measured when lock comes off. Pull out speed 25 mm/min	
5-2-6	圧着部引張強度 Contact Crimp Strength	電 線 Wire Size		強 度 Strength N 以上 or more	コンタクトのワイヤバレルと電線導体を圧着し、治具で固定し電線の軸方向に引っ張る。 試験速度 25mm/min Crimping the wire and wire barrel of contact after which measurement shall be made. Pull out speed 25 mm/min
		mm ²	AWG		
		0.08	AWG#28	9.8	
		0.13	AWG#26	19.6	
		0.21	AWG#24	29.4	
0.33	AWG#22	44.1			
5-2-7	ウエハー 角ピン保持力 Wafer Pin Holding Force	9.8 N 以上 or more		ウエハーとコンタクトの保持力を万能試験機を用いて測定する。 試験速度 25mm/min The Max. force before the pin is divorced from wafer shall be measured. Pull out speed 25 mm/min	

5-3 電気的性能(Electrical Characteristics)

No.	項 目 Items	規 格 値 Requirement	試 験 条 件 及 び 方 法 Conditions and methods
5-3-1	接 触 抵 抗 Contact Resistance	初期 At beginning 1 0 m 以下 or less	コネクタを嵌合状態にして電気抵抗を測定し、電線抵抗を差し引いて接触抵抗とする。 試験電流 15mA以下 (20mV以下) At mating condition of connectors, the resistance which wire resistance is deducted shall be measured. Test Current 15mA or less (20 mV or less)
5-3-2	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	初期 At beginning 1 0 0 0 M 以上 or more	コネクタ外面とコンタクト相互間及び隣接するコンタクト間にて測定する。 Between contact and housing, and between neighbor contacts,
5-3-3	耐 電 圧 Withstand Voltage	AC 1 0 0 0 V / 1 min 異常なきこと Without distinct damage.	コネクタ外面とコンタクト相互間及び隣接するコンタクト間にて測定する。 Between contact and housing, and between neighbor contacts.
5-3-4	温 度 上 昇 Temperature Rise	3 0 K 以下 or less (AWG# 2 2)	ハウジングの全極にコンタクトを装着し、嵌合させて各コンタクトを直列に接続し、最大定格電流を通電した時のコンタクト部の温度上昇を測定する。 Attaching contact to all the poles of housing, and the contact temperature rise at Max. current shall be measured with serial connection.

5-4 耐久環境性能(Endurance Characteristics)

No.	項 目 Items	規 格 値 Requirement		試 験 条 件 及 び 方 法 Conditions and methods
5-4-1	挿 抜 寿 命 Endurance	接触抵抗 Contact Resistance	20 m 以下 or less	ハウジングにコンタクトを装着し、 ウエハーにハウジングを挿抜(30回) 試験前後の接触抵抗を測定する。 Inserting and withdrawing 30 times, before and after which measurement shall be made.
		外 観 Appearance	異常なきこと Without distinct damage.	
5-4-2	耐 振 動 性 Vibration	接触抵抗 Contact Resistance	20 m 以下 or less	コネクタを結合し、下記条件にて 振動試験実施。 Mating connectors, test shall be made under following conditions. 掃引割合(Freq.) 10~55~10Hz 掃引時間(Time) 1分 最大振幅(Width) 1.5 mm 振動軸方向(Dir.) X、Y、Z 振動時間 各2時間=6時間 Test Time 2 hours/each = 6 hours
		電流瞬断 Current disconnect	1 μ s 以下 or less	
		外 観 Appearance	異常なきこと Without distinct damage	
5-4-3	耐 塩 水 噴 霧 性 Withstand Salt Mist	接触抵抗 Contact Resistance	20 m 以下 or less	コネクタを結合後、下記条件に放置 Mating connectors, the test shall be maintained under following conditions. 温度(Temperature) 35 \pm 2 塩水濃度(Salt Ratio) 5 \pm 1 % (重量比 Weight) 噴霧時間(Time) 48時間(Hours) 接触抵抗測定は、水洗をし室温で 乾燥後測定。 Measurement shall be made after washing and drying at ambient temperature.
		絶縁抵抗 Insulation Resistance	500 M 以上 or more	
		耐 電 圧 Withstand Voltage	AC500V/1min. 異常なきこと Without distinct damage.	
		外 観 Appearance	異常なきこと Without distinct damage.	

仕 様 書 SPECIFICATIONS

SA-1381S-E4-9/12

No.	項 目 Items	規 格 値 Requirement	試 験 条 件 及 び 方 法 Conditions and methods	
5-4-4	耐 湿 性 Damp heat	接触抵抗 Contact Resistance	コネクタを結合後、下記条件に放置 Mating connectors, then it shall be maintained under following conditions. 雰囲気温度(Test Temp.) 60 ± 2 相対湿度(Relative humidity) $90 \sim 95\% \text{ RH}$ 放置時間(Test Time) 240 Hours 1 ~ 2時間放置後測定 Ambient Laying Time 1 ~ 2 hours	
		20 m 以下 or less		
		絶縁抵抗 Insulation Resistance		500 M 以上 or more
		耐電圧 Withstand Voltage		AC500V/1min. 異常なきこと Without distinct damage.
外 観 Appearance	異常なきこと Without distinct damage.			
5-4-5	耐 熱 性 Dry Heat	接触抵抗 Contact Resistance	コネクタを結合後、下記条件に放置 Mating connectors, then it shall be maintained under following conditions. 雰囲気温度(Test Temp.) 100 ± 2 放置時間(Test Time) 240 Hours 1 ~ 2時間放置後測定 Ambient Laying Time 1 ~ 2 hours	
		20 m 以下 or less		
		外 観 Appearance	異常なきこと Without distinct damage.	
5-4-6	耐 寒 性 Cold Proof	接触抵抗 Contact Resistance	コネクタを結合後、下記条件に放置 Mating connectors, then it shall be maintained under following conditions. 雰囲気温度(Test Temp.) -40 ± 2 放置時間(Test Time) 240 Hours 1 ~ 2時間放置後測定 Ambient Laying Time 1 ~ 2 hours	
		20 m 以下 or less		
		外 観 Appearance	異常なきこと Without distinct damage.	

仕 様 書 SPECIFICATIONS

SA-1381S-E4-10/12

No.	項 目 Items	規 格 値 Requirement	試 験 条 件 及 び 方 法 Conditions and methods
5-4-7	耐 熱 衝 撃 性 Shock Heat	接触抵抗 Contact Resistance	2 0 m 以下 or less
		絶縁抵抗 Insulation Resistance	5 0 0 M 以上 or more
		耐 電 圧 Withstand Voltage	AC500V/ 1min. 異常なきこと Without distinct damage.
		外 観 Appearance	異常なきこと Without distinct damage.
コネクタを結合後、下記条件に放置 Mating connectors, then temperature cycle test shall be made under following conditions. 1. 低温側 - 5 5 \pm 0 ₋₃ 3 0 分. (Low Temp. 30 min.) 2. 室 温 + 2 5 \pm 1 ₋₅ ⁰ 5 分以内 (Room Temp. in 5 min.) 3. 高温側 + 8 5 \pm 3 ₋₀ 3 0 分. (High Temp. 30 min.) 4. 室 温 + 2 5 \pm 1 ₋₅ ⁰ 5 分以内 (Room Temp. in 5 min.) 1 ~ 4 を 2 5 サイクル行う。 Total 25 cycles(1 ~ 4)			
5-4-8	耐硫化水素ガス性 Hydrogen Sulphide Gas	接触抵抗 Contact Resistance	2 0 m 以下 or less
		外 観 Appearance	異常なきこと Without distinct damage.
コネクタを結合後、下記硫化水素ガス中に放置。 Mating connectors, then it shall be maintained in Hydrogen sulphide gas under the following conditions. 濃度(Density) 3 \pm 1 ppm 温度(Temp.) 4 0 \pm 2 放置時間(Time) 9 6 Hours 1 ~ 2 時間放置後測定。 Ambient Laying Time 1 ~ 2 hours			
5-4-9	耐アンモニア性 Ammonia	接触抵抗 Contact Resistance	2 0 m 以下 or less
		外 観 Appearance	異常なきこと Without distinct damage.
コネクタを結合後、下記アンモニア水の入ったデシケータ容器中に放置 Mating connectors, then it shall be maintained in desiccator with Ammonia water. 濃度(Density) 28 % 温度(Temp.) 25 放置時間(Time) 40 Hours 1 ~ 2 時間放置後測定。 Ambient Laying Time 1 ~ 2 hours			

5-5 半田付性能(Soldering characteristics)

No.	項 目 Items	規 格 値 Requirements	試 験 条 件 及 び 方 法 Conditions and Methods
5-5-1	半 田 付 性 Solder Ability	濡れ性 浸漬面積の90%以上 Immersion Characteristics Immersion area 90% or more	ウエーの角ピン半田付部をフラックスに 5～10秒浸漬後、下記条件の半田槽に浸 漬する。 Inserting the solder part into flux for 5~10 min., then immersing it into the solder tank. 半田槽温度(Solder Temp.) 230 ± 5 浸漬時間(Immersion Time) 3 ± 0.5 Sec
5-5-2	半 田 耐 熱 性 Resistance to Soldering Heat	外 観 ウエハー Ass'yに 割れ・変形なきこと Appearance Without any broken and deformation in wafer Ass'y	下記半田槽にウエハー角ピン半田付部を浸 漬する。 Immersing the pin of wafer into the solder tank: 半田槽温度(Solder Temp.) 260 ± 5 浸漬時間(Time) 5 ± 1 Sec \triangle 浸漬深さ(Immersion Depth) 1 mm

6 . 梱包・表示(PACKING・MARKING)

6-1 コンタクト(Contacts)

コンタクトはリールに巻き、さらにダンボール箱に梱包して出荷。
表示はリールに型番、数量、ロットNo.を明記したラベルを貼り付ける。
Contacts shall be wound into reel, and packed into carton before shipping.
Label on which product No., quantity and lot No. must be marked shall be
sticked on the reel.

6-2 ハウジング・ウエハー(Housing, Wafer)

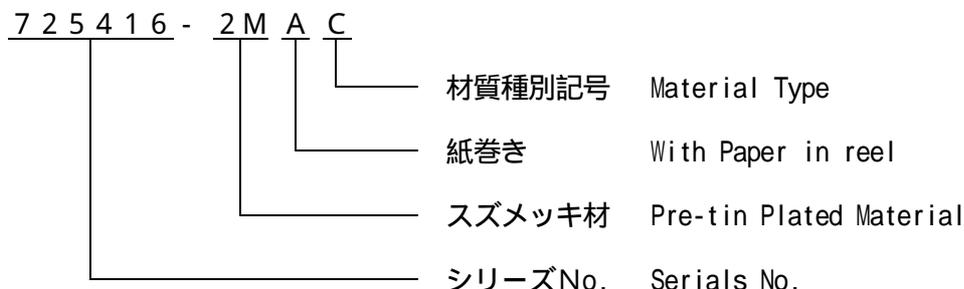
ナイロン袋に入れ、さらに、ダンボール箱に梱包して出荷。
表示はナイロン袋、ダンボール箱に型番、数量、ロットNo.を明記した
ラベルを貼り付ける。
Housings shall be put into nylon bag, and packed into carton before shipping.
Label on which product No., quantity and lot No. must be marked shall be
sticked on the nylon bag and carton box.

仕様書 SPECIFICATIONS

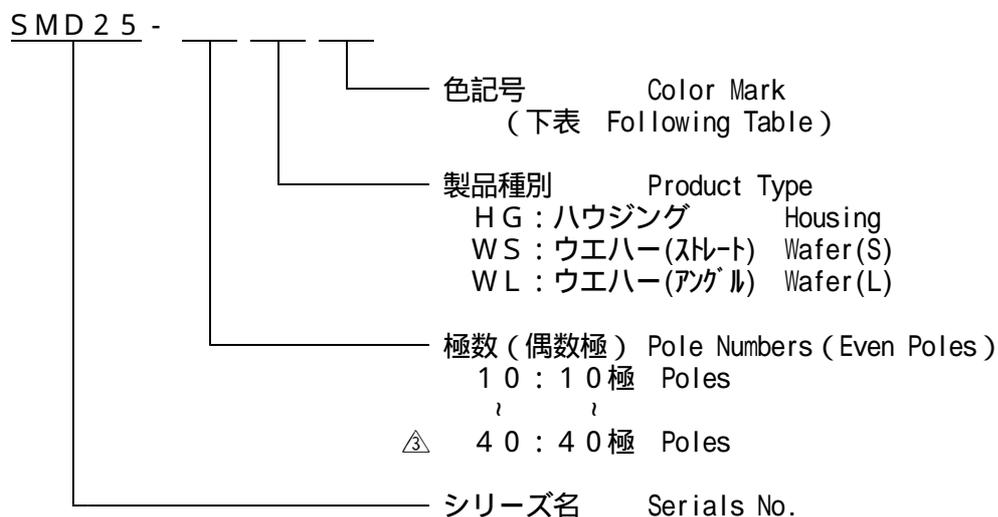
SA-1381S-E4-12/12

7. 品番構成(CONSISTS OF PRODUCTS)

<コンタクト Contact >



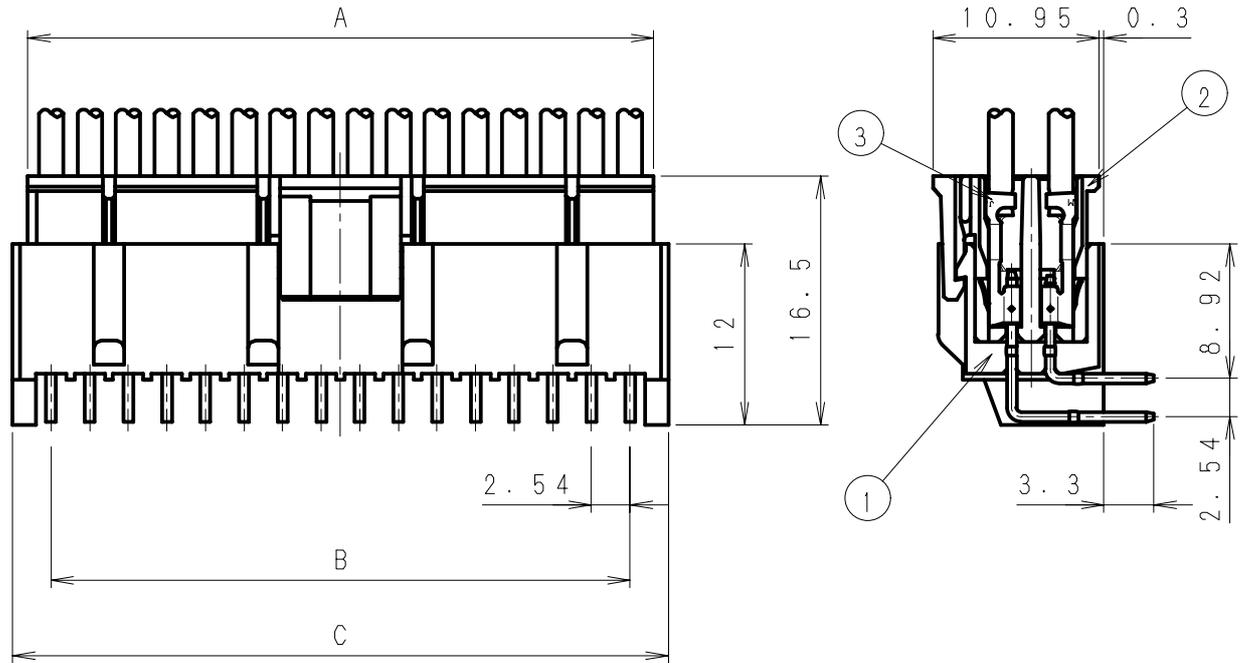
<ハウジング・ウエハー Housing・Wafer >



<色記号 Color Mark >

記号 Mark	無 None	R E	P K	B R	G Y	Y G
色 Color	白 White	赤 Red	桃 Pink	紫 Purple	灰 Grey	若草 Young Grass
記号 Mark	Y L	O R	B W	B L	G R	B K
色 Color	黄 Yellow	橙 Orange	茶 Brown	青 Blue	緑 Green	黒 Black

極数 Poles	A	B	C
32	41.18	38.10	43.18
34	43.72	40.64	45.72
36	46.26	43.18	48.26
38	48.80	45.72	50.80
40	51.34	48.26	53.34



No.	製品番号 PRODUCT NO.	製品名 PRODUCT NAME	材質 MATERIAL
①	SMD25-□DWL	ウェハー WAFER	ナイロン66 (GF入り) NYLON66 (GF)
②	SMD25-□DHG	ハウジング HOUSING	ナイロン66 NYLON66
③	725416-2MAC	コンタクト CONTACT	リン青銅 Phosphor Bronze

極数 Poles	32~40
適応電線 Wire	AWG#22~#28
被覆外径 Insu. Wire	MAXφ1.7

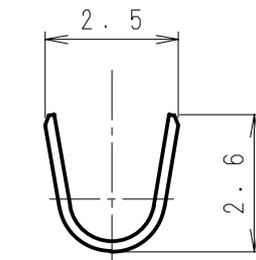
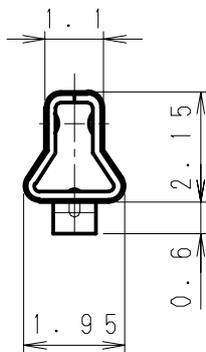
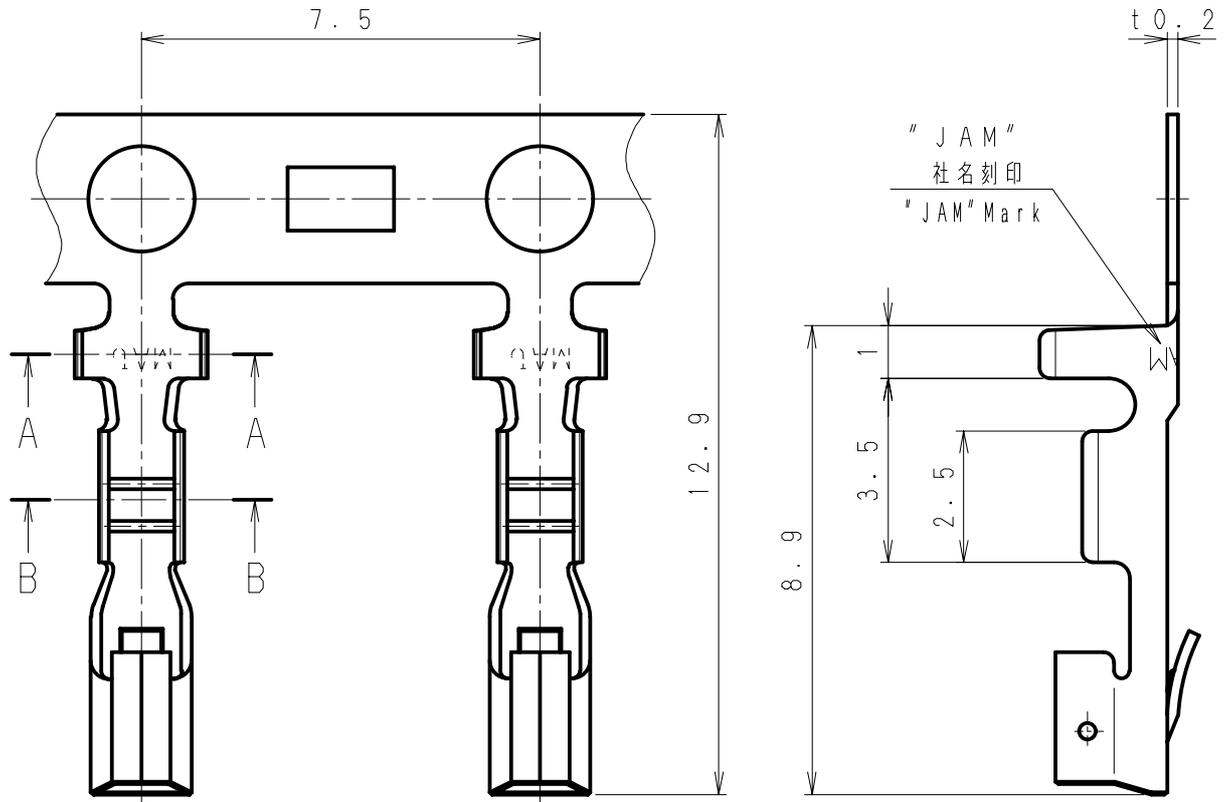
△6	. .								
△5	. .								
△4	. .								
△3	. .								
△2	. .								
△1	. .								
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP	製品番号 PRODUCT No.	No.	材 料 MATERIAL	備考 NOTE	色 COLOR
承認 APPROVED	Y. Horiuchi	確認 CHECKED	A. Kumakura	一般公差 TOLERANCE	±0.3	尺度 SCALE	3/1	製品名 NAME	SMD コネクタ (アングル型) SMD CONNECTOR (L-Type)
設計 DESIGN	Y. Shimizu	製図 DRAWING	Y. Shimizu	JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.					
					図番 DRAWING No. JC-0807-78E				

第三角法
3rd ANGLE PROJECTION

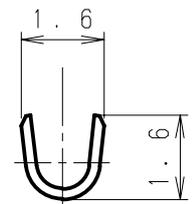
単位: mm
UNIT: mm

注) 図面を実測しないこと
NOTES) DO NOT SCALE

図番 DRAWING No.
JC-0807-02E



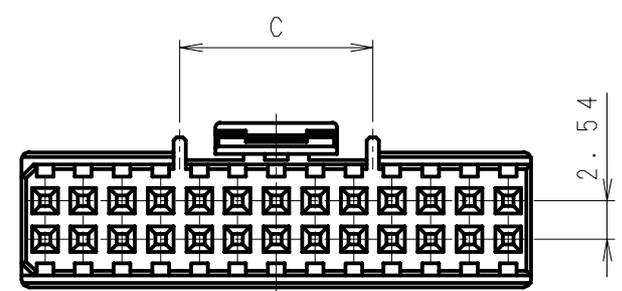
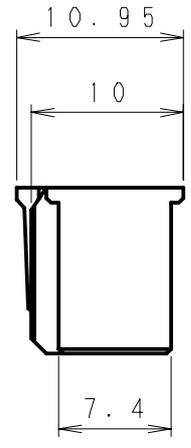
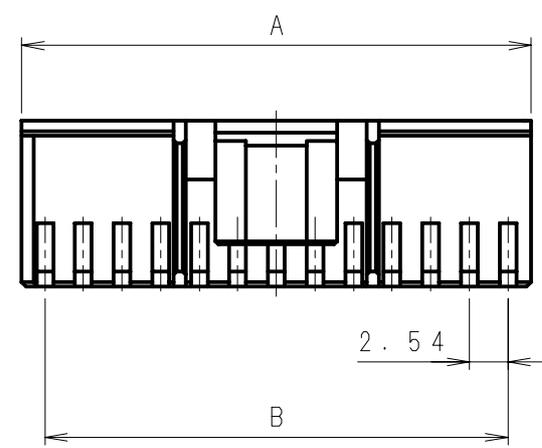
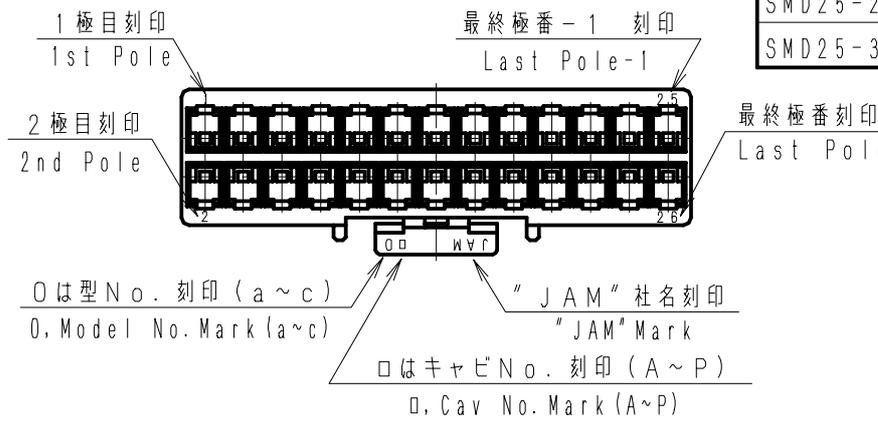
SEC A-A



SEC B-B

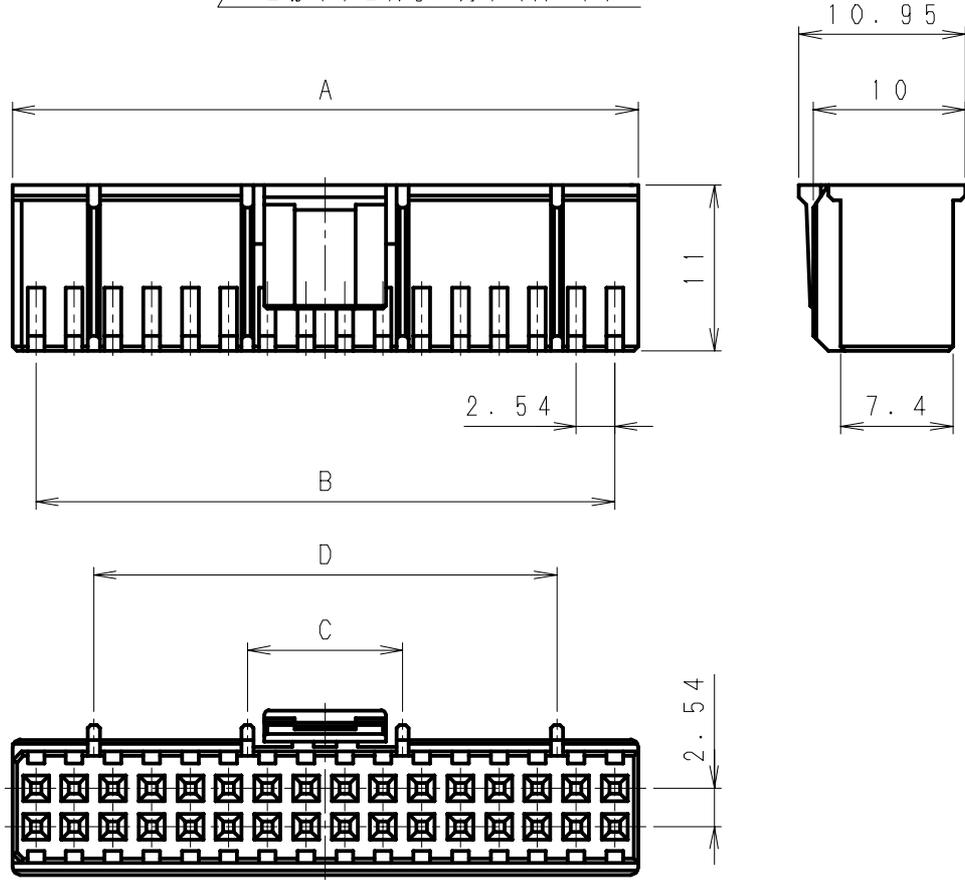
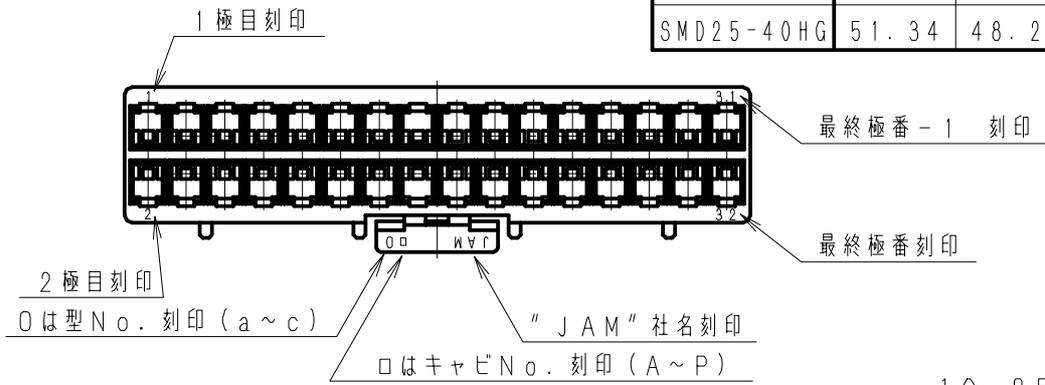
△6	. .							
△5	. .							
△4	. .				725416-2MAC	リン青銅 Phosphor Bronze	錫鍍金材 Pre-tin Plated	MAX φ1.7 AWG#22~#28
△3	. .				製品番号 PRODUCT No.	材料 MATERIAL	表面処理 FINISH	適応電線 INSULATION DIA
△2	. .							被覆外径 WIRE SIZE
△1	. .							
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP	製品名 NAME		コンタクト CONTACT	
承認 APPROVED	確認 CHECKED		一般公差 TOLERANCE	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.			
K. Shiine	Y. Horiuchi		±0.3	7/1	JC-0807-02E			
設計 DESIGN	製図 DRAWING		 JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.					
K. Kusano	K. Kusano							

品番 PRODUCT No.	A	B	C
SMD25-26HG	33.56	30.48	12.7
SMD25-28HG	36.10	33.02	10.2
SMD25-30HG	38.64	35.56	12.7

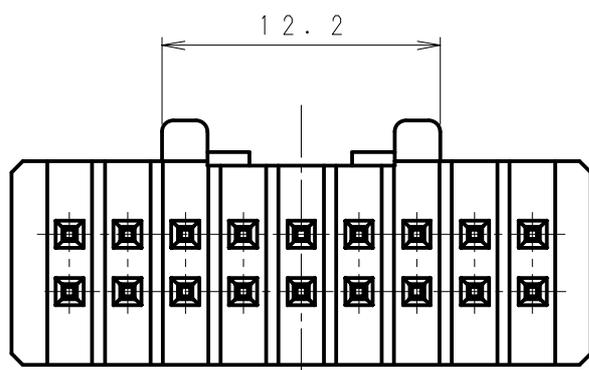
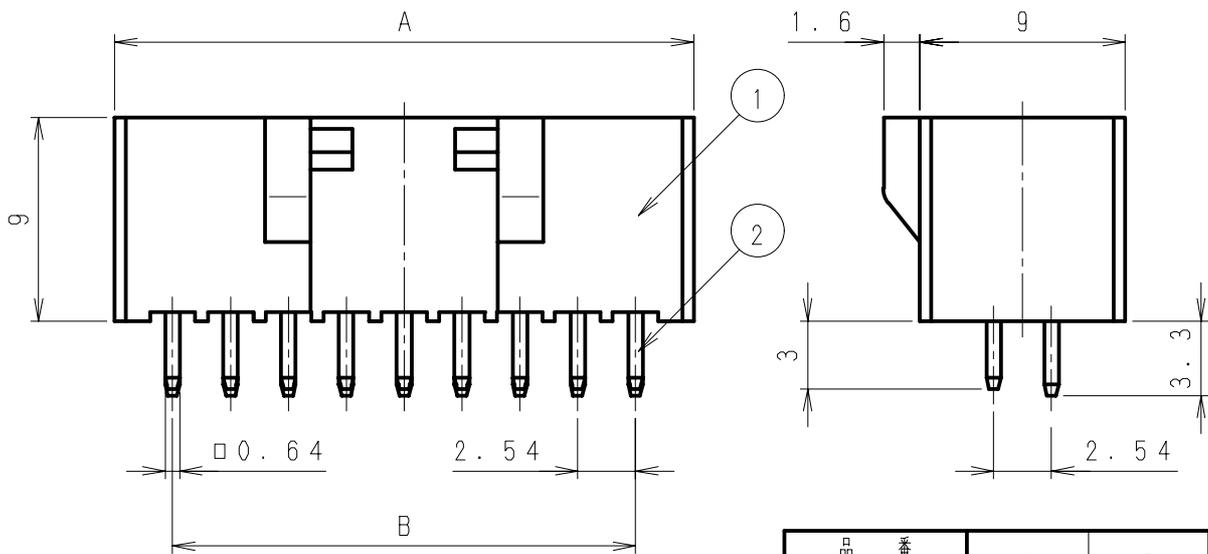
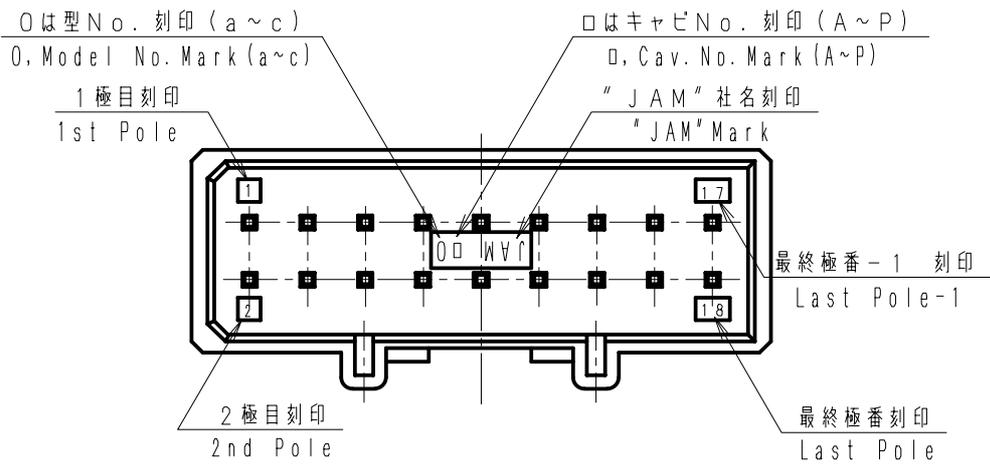


△6	. .							
△5	. .							
△4	. .							
△3	. .				SMD25-00HG	ナイロン66 NYLON66	UL94 V-0	
△2	. .				製品番号 PRODUCT No.	材 料 MATERIAL	備考 NOTE	色 COLOR
△1	. .				No.			
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP	製品名 NAME		SMDハウジング SMD HOUSING	
承認 APPROVED	確認 CHECKED		一般公差 TOLERANCE		尺度 SCALE	図番 DRAWING No.		
K. Shiine	Y. Horiuchi		±0.3		2/1	JC-0807-09E		
設計 DESIGN	製図 DRAWING		JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.					
K. Kusano	K. Kusano							

品番 PRODUCT No.	A	B	C	D
SMD25-32HG	41.18	38.10	10.2	30.48
SMD25-34HG	43.72	40.64	12.7	33.02
SMD25-36HG	46.26	43.18	10.2	35.56
SMD25-38HG	48.80	45.72	12.7	38.10
SMD25-40HG	51.34	48.26	10.2	40.64

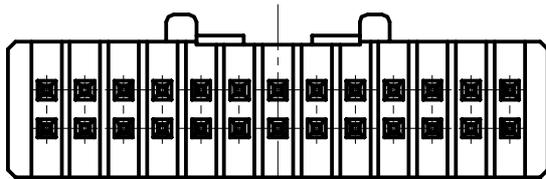
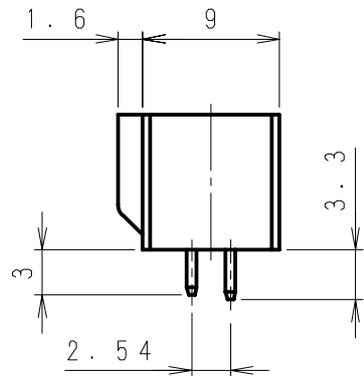
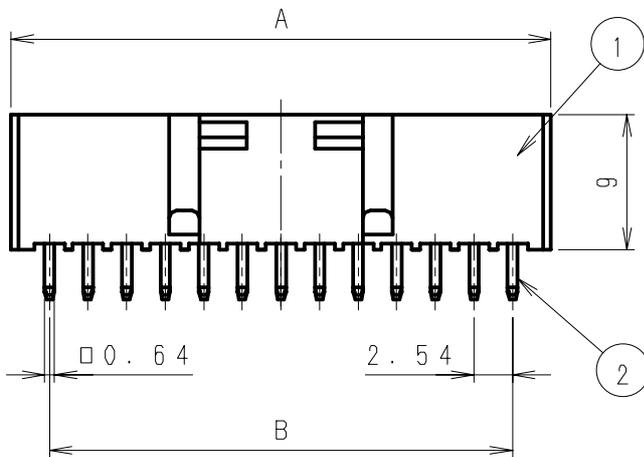
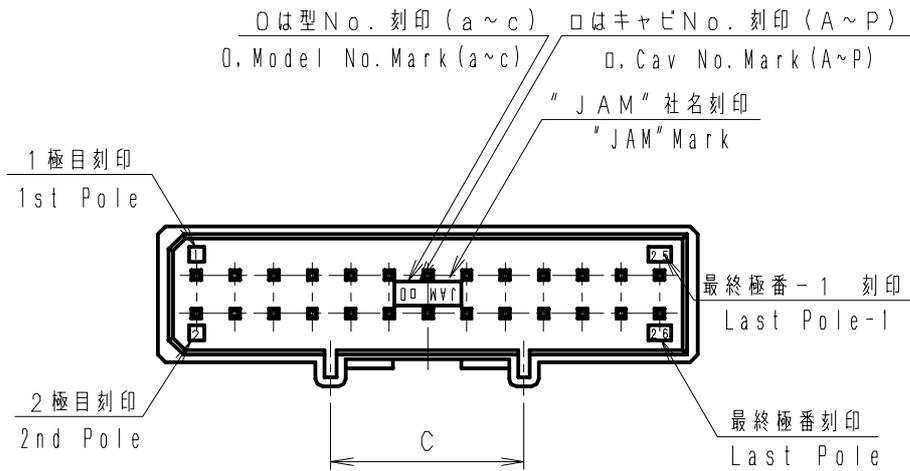


△6	. .							
△5	. .							
△4	. .							
△3	. .				SMD25-00HG	ナイロン66 NYLON66	UL94 V-0	
△2	. .				製品番号 PRODUCT No.	材 料 MATERIAL	備考 NOTE	色 COLOR
△1	. .				No.			
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP	製品名 NAME		SMDハウジング SMD HOUSING	
承認 APPROVED	Y. Horiuchi	確認 CHECKED	A. Kumakura	一般公差 TOLERANCE	±0.3	尺度 SCALE	2/1	図番 DRAWING No.
設計 DESIGN	Y. Shimizu	製図 DRAWING	Y. Shimizu	J.A.M. JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.				



品番 PRODUCT No.	A	B
SMD25-10WS	15.24	10.16
SMD25-12WS	17.78	12.70
SMD25-14WS	20.32	15.24
SMD25-16WS	22.86	17.78
SMD25-18WS	25.40	20.32
SMD25-20WS	27.94	22.86
SMD25-22WS	30.48	25.40
SMD25-24WS	33.02	27.94

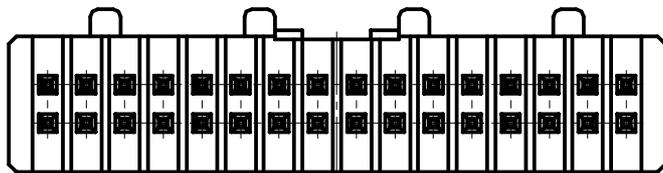
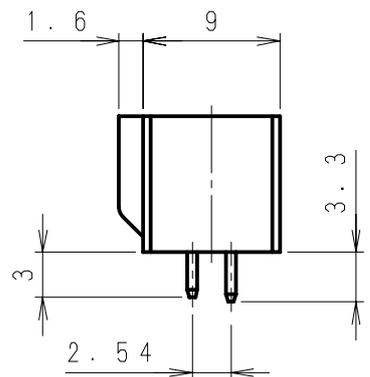
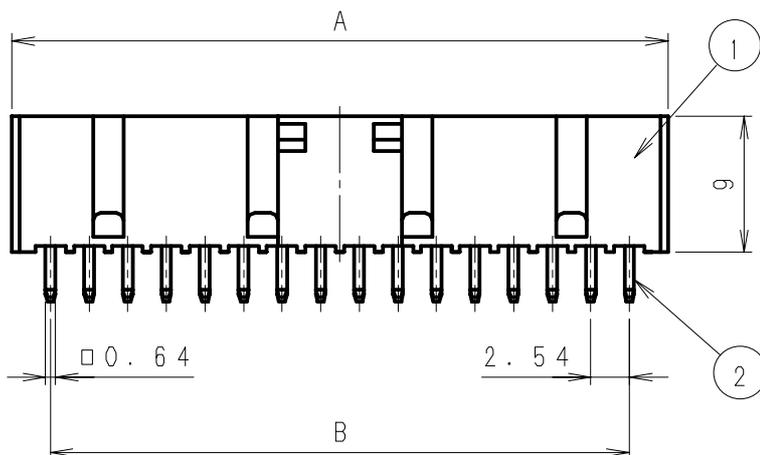
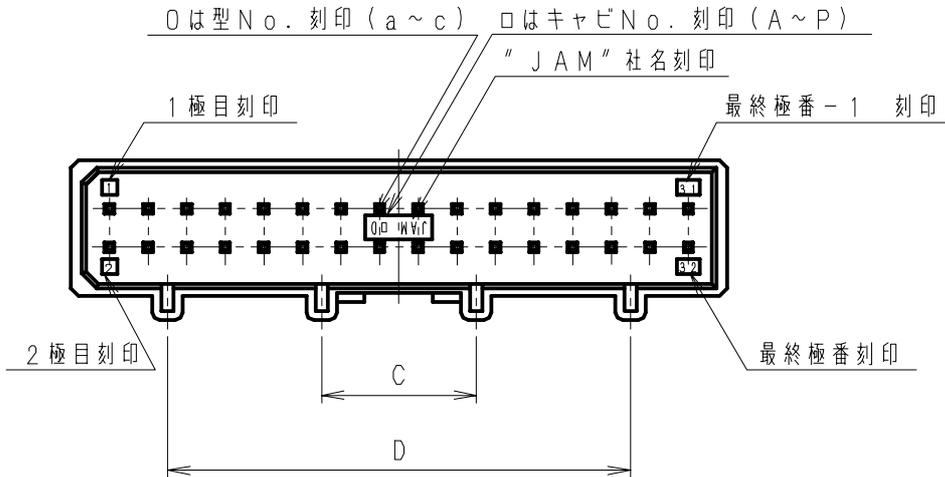
④					②	黄銅 Brass	△△半田鍍金又は錫鍍金 Solder Plating or Tin Plating
③				SMD25-□□WS	①	ナイロン66 (GFA) NYLON66 (GF)	UL94 V-0
△	04.12.8	半田メッキ削除 Solder Plating deletion.	N. Y. Y. H	製品番号 PRODUCT No.	No.	材 料 MATERIAL	備 考 NOTE
△	03.2.20	角ピンメッキ追加 Pin Plating addition.	K. K. Y. H				
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計承認 DESIGN APP	製品名 NAME		SMDウエハー(ストレート型) SMD WAFER (S-Type)	
承認 APPROVED	K. Shiine	確認 CHECKED	Y. Horiuchi	一般公差 TOLERANCE	±0.3	尺度 SCALE	3/1
設計 DESIGN	K. Kusano	製図 DRAWING	K. Kusano	JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.			
						図番 DRAWING No. JC-0807-04E	



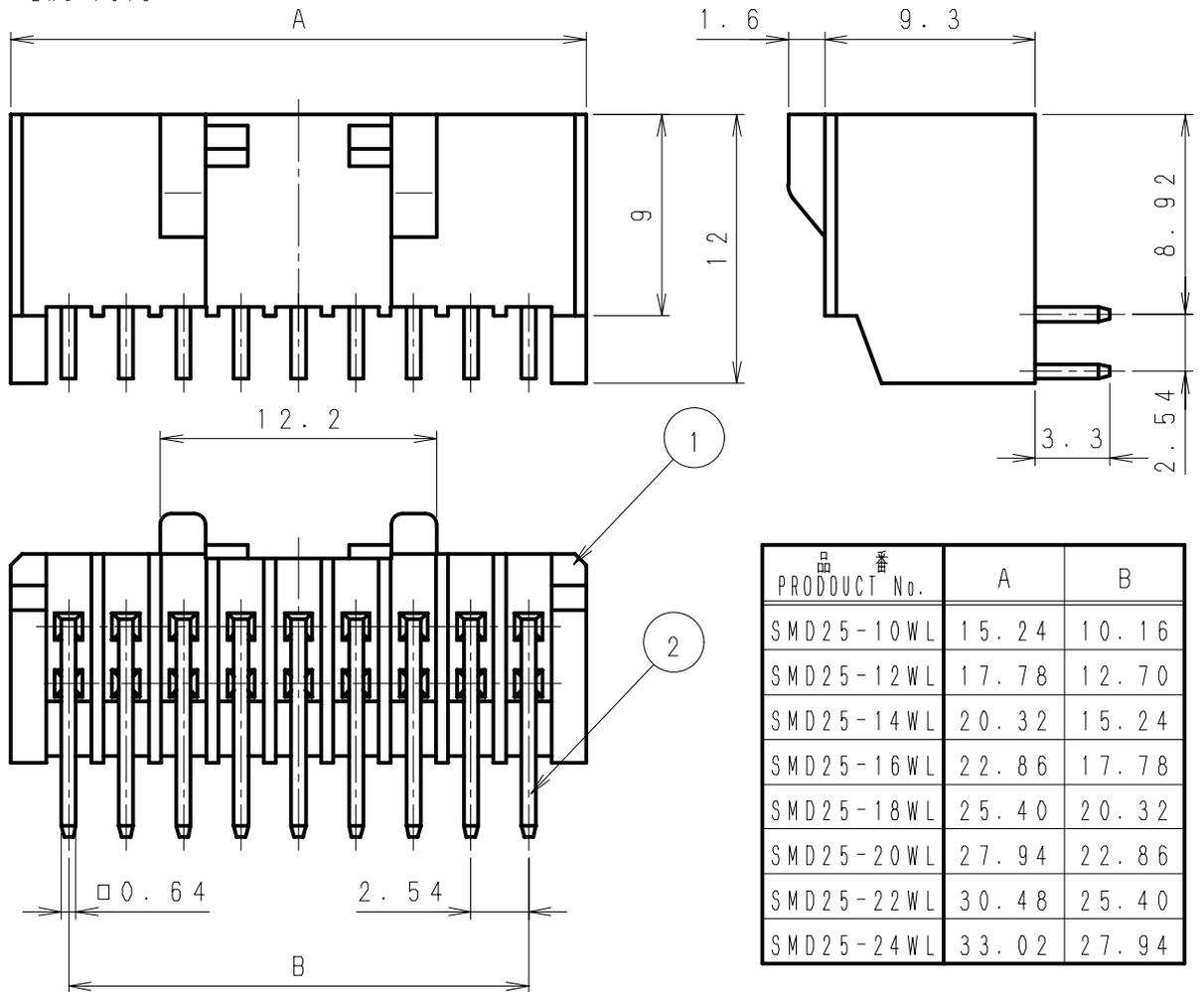
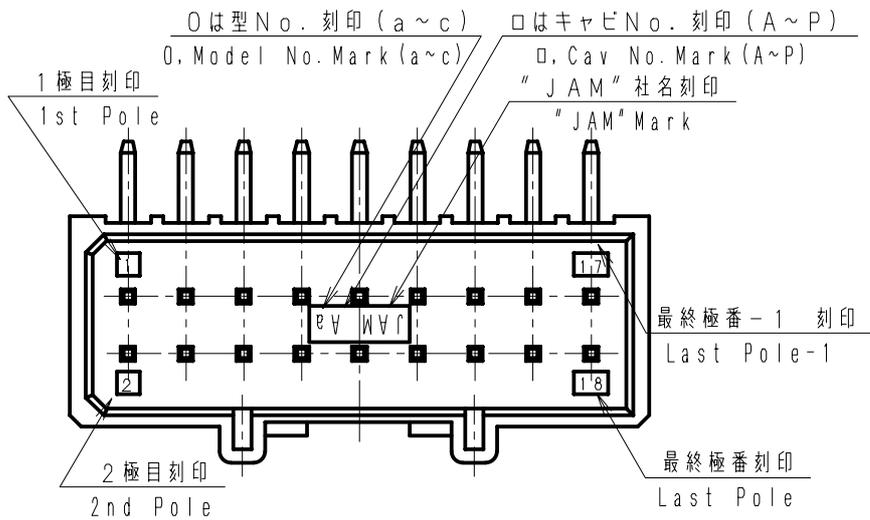
品番 PRODUCT No.	A	B	C
SMD25-26WS	35.56	30.48	12.7
SMD25-28WS	38.10	33.02	10.2
SMD25-30WS	40.64	35.56	12.7

④	. .			SMD25-□□WS	②	黄銅 Brass	△△ 半田鍍金又は錫鍍金 Solder Plating or Tin Plating
③	. .				①	ナイロン66 (GFA) NYLON66 (GF)	UL94 V-0
△	04.12.8	半田メッキ削除 Solder Plating deletion.	N. Y. H.	製品番号 PRODUCT No.	No.	材 料 MATERIAL	備 考 NOTE
△	03.2.20	角ピンメッキ追加 Pin Plating addition.	K. K. Y. H.				
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計承認 DESIGN APP	製品名 NAME		SMDウエハー (ストリート型) SMD WAFER (S-Type)	
承認 APPROVED K. Shiine	確認 CHECKED Y. Horiuchi	一般公差 TOLERANCE ±0.3	尺度 SCALE 2/1	図番 DRAWING No. JC-0807-10E			
設計 DESIGN K. Kusano	製図 DRAWING K. Kusano	JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.					

品番 PRODUCT No.	A	B	C	D
SMD25-32WS	43.18	38.10	10.2	30.48
SMD25-34WS	45.72	40.64	12.7	33.02
SMD25-36WS	48.26	43.18	10.2	35.56
SMD25-38WS	50.80	45.72	12.7	38.10
SMD25-40WS	53.34	48.26	10.2	40.64



△6	. .				SMD25-□□WS	②	黄銅 Brass	錫鍍金 Tin Plating
△5	. .					①	ナイロン66 (GFA) NYLON66 (GF)	UL94 V-0
△4	. .						材 料 MATERIAL	備 考 NOTE
△3	. .				製品番号 PRODUCT No.	No.		
△2	. .						製品名 NAME	SMDウエハー (ストレート型) SMD WAFER (S-Type)
△1	. .							
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP	一般公差 TOLERANCE ±0.3	尺度 SCALE 3/1	図番 DRAWING No.	JC-0807-77E
承認 APPROVED Y. Horiuchi	確認 CHECKED A. Kumakura							
設計 DESIGN Y. Shimizu	製図 DRAWING Y. Shimizu	JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.						



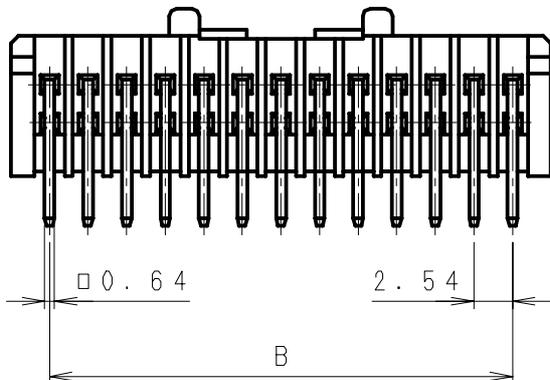
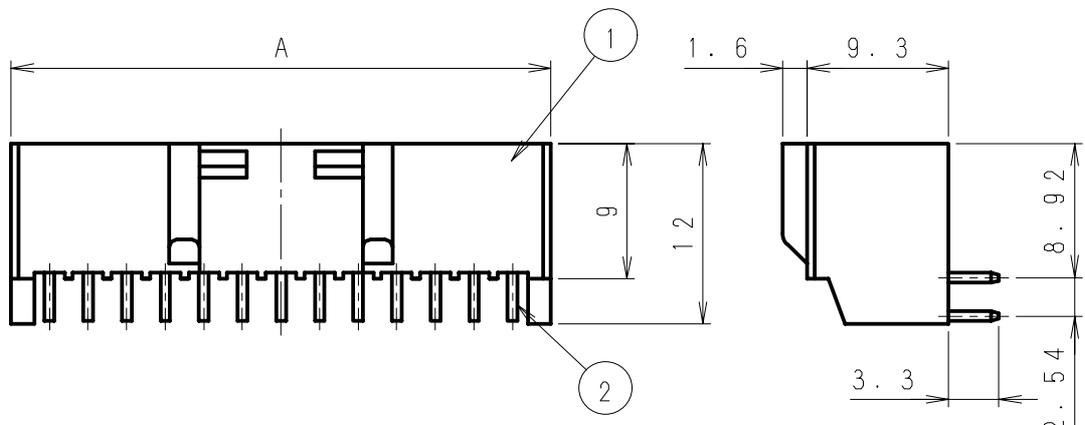
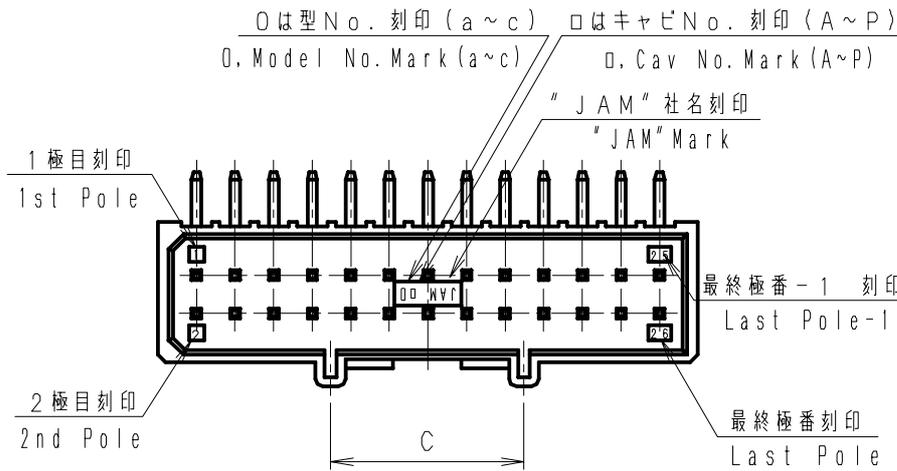
品番 PRODUCT No.	A	B
SMD25-10WL	15.24	10.16
SMD25-12WL	17.78	12.70
SMD25-14WL	20.32	15.24
SMD25-16WL	22.86	17.78
SMD25-18WL	25.40	20.32
SMD25-20WL	27.94	22.86
SMD25-22WL	30.48	25.40
SMD25-24WL	33.02	27.94

④					②	黄銅 Brass	△② 半田鍍金又は錫鍍金 Solder Plating or Tin Plating
③				SMD25-□□WL	①	ナイロン66 (GFA) NYLON66 (GF)	UL94 V-0
△	04.12.8	半田メッキ削除 Solder Plating deletion.	N. Y. H.	製品番号 PRODUCT No.	No.	材 料 MATERIAL	備 考 NOTE
△	03.2.20	角ピンメッキ追加 Pin Plating addition.	K. K. Y. H.				
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計承認 DESIGN APP	製品名 NAME		SMDウエハー (アングル型) SMD WAFER (L-Type)	
承認 APPROVED	K. Shiine	確認 CHECKED	Y. Horiuchi	一般公差 TOLERANCE	±0.3	尺度 SCALE	3/1
設計 DESIGN	K. Kusano	製図 DRAWING	K. Kusano	図番 DRAWING No. JC-0807-06E			
JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.							

第三角法
3rd ANGLE PROJECTION

単位: mm 注) . . . 図面を実測しないこと
UNIT: mm NOTES) . . . DO NOT SCALE

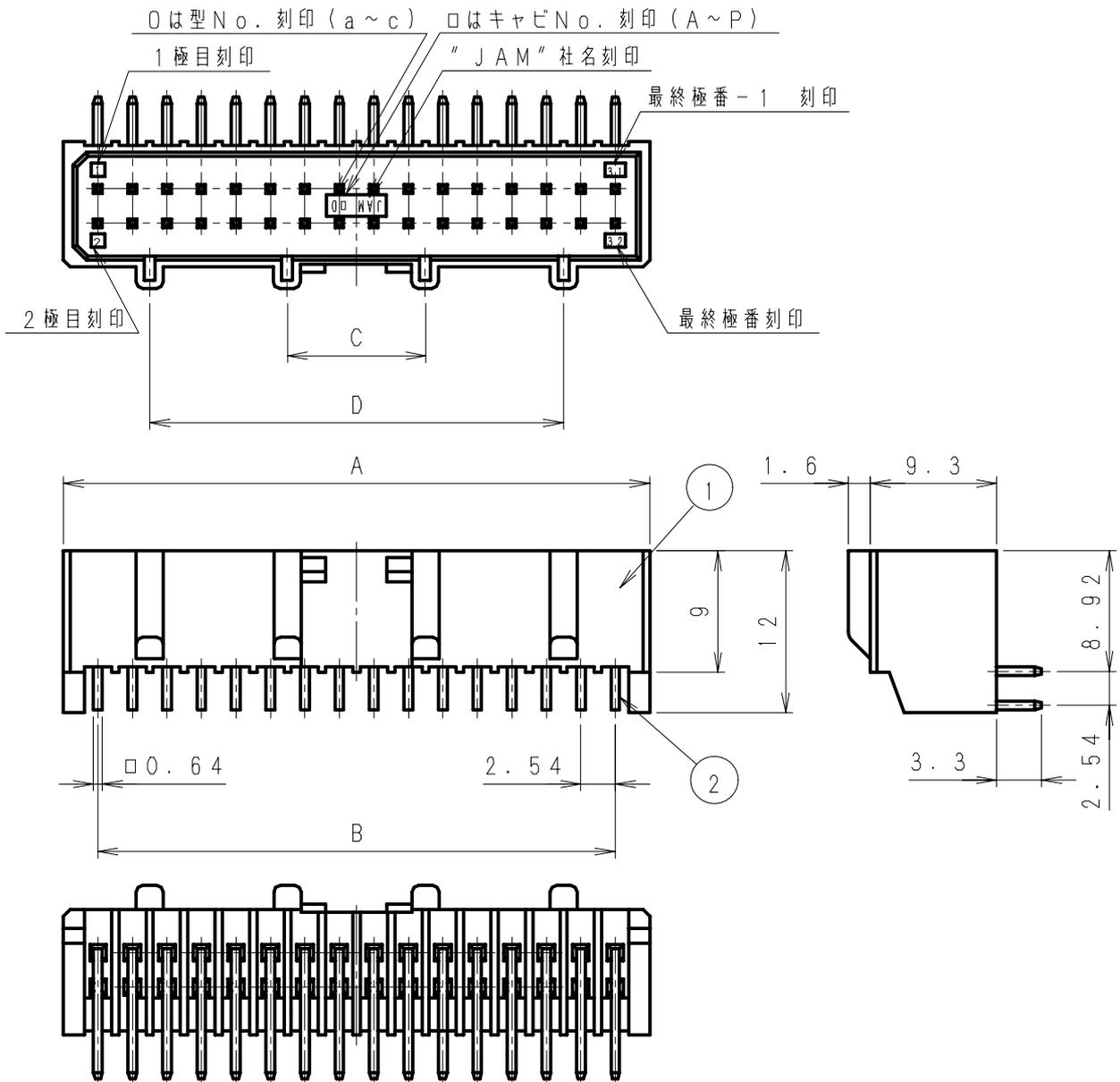
図番 DRAWING No.
JC-0807-11E



品番 PRODUCT No.	A	B	C
SMD25-26WL	35.56	30.48	12.7
SMD25-28WL	38.10	33.02	10.2
SMD25-30WL	40.64	35.56	12.7

④	. .			SMD25-□□WL	②	黄銅 Brass	△△半田鍍金又は錫鍍金 Solder Plating or Tin Plating
③	. .				①	ナイロン66 (GFA) NYLON66 (GF)	UL94 V-0
△	04.12.8	半田メッキ削除 Solder Plating deletion.	N. Y. H.	製品番号 PRODUCT No.	No.	材 料 MATERIAL	備 考 NOTE
△	03.2.20	角ピンメッキ追加 Pin Plating addition.	K. K. Y. H.				
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計承認 DESIGN APP	製品名 NAME		SMDウエハー (アングル型) SMD WAFER (L-Type)	
承認 APPROVED	K. Shiine	確認 CHECKED	Y. Horiuchi	一般公差 TOLERANCE	±0.3	尺度 SCALE	2/1
設計 DESIGN	K. Kusano	製図 DRAWING	K. Kusano	 JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.			
				図番 DRAWING No. JC-0807-11E			

品番 PRODUCT No.	A	B	C	D
SMD25-32WL	43.18	38.10	10.2	30.48
SMD25-34WL	45.72	40.64	12.7	33.02
SMD25-36WL	48.26	43.18	10.2	35.56
SMD25-38WL	50.80	45.72	12.7	38.10
SMD25-40WL	53.34	48.26	10.2	40.64



△6	. .						②	黄銅 Brass	錫鍍金 Tin Plating
△5	. .						①	ナイロン66 (GFA) NYLON66 (GF)	UL94 V-0
△4	. .								
△3	. .								
△2	. .								
△1	. .								
記号 No.	年月日 DATE	変更記事 REVISION RECORD	設計 DESIGN	承認 APP	製品番号 PRODUCT No.	No.	材 料 MATERIAL	備 考 NOTE	製品名 NAME
承認 APPROVED	Y. Horiuchi	確認 CHECKED	A. Kumakura	一般公差 TOLERANCE ±0.3	尺度 SCALE 3/1	図番 DRAWING No.	SMDウエハー (アングル型) SMD WAFER (L-Type) JC-0807-79E		
設計 DESIGN	Y. Shimizu	製図 DRAWING	Y. Shimizu	JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.					